

(四) 112 年發明專利新申請案件數依國際專利三階分類排行 (前 20 名)

排名	國際專利分類 (三階)	分類內容簡述	件數
1	H01L	半導體裝置；其他類目不包括的電固體裝置	5,496
2	G06F	電子數位資料處理	2,558
3	A61K	醫用、牙科用或梳妝用之配製品	2,032
4	G06Q	電子商務	1,153
5	G02B	光學元件、系統或儀器	1,126
6	G03F	圖紋面之照相製版工藝；其所用材料；其所用原版；其所專用設備	910
7	H05K	印刷電路；電氣設備之外殼或結構零部件；電氣元件組件之製造	864
8	C07D	雜環化合物	812
9	C23C	對金屬材料之鍍覆；用金屬材料對材料之鍍覆	805
10	H10D	無機電子半導體裝置	798
11	H04W	無線通訊網路	765
12	H04N	影像通信	759
13	C07K	肽類	727
14	H10B	電子儲存設備	715
15	C08G	用碳 - 碳不飽和鍵以外之反應而得的高分子化合物	681
16	G01N	借助於測定材料之化學或物理性質用以測試或分析材料	672
17	G01R	測量電變量；測量磁變量	657
18	B32B	層狀產品，即由扁平的或非扁平的薄層	630
19	H01J	電子管或放電燈	623
19	H04L	數位資訊之傳輸	623

統計日期：114 年 1 月 11 日

註：1. 依專利申請案件數由大至小排序。

2. 詳細之國際專利分類內容描述請見國際專利分類第 2023.01 版。

3. 新申請案件因尚有分類時程之落差，無法及時提供年報當年度件數，爰以年報年度以前 1 年之件數為統計基礎。